

MEIKO REPORT

第47期 第2四半期 株主通信

(2021年4月1日から2021年9月30日)

証券コード：6787

株式会社 メイコー

財務ハイライト

売上高

69,470 百万円

営業利益

5,549 百万円

親会社株主に帰属する四半期純利益

4,190 百万円

連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前期末 2020年3月31日現在	当第2四半期末 2021年9月30日現在
資産の部		
流動資産	66,338	75,940
固定資産	75,701	77,127
有形固定資産	68,786	70,063
無形固定資産	927	962
投資その他の資産	5,987	6,101
資産合計	142,040	153,068
負債の部		
流動負債	59,182	69,471
固定負債	42,247	39,269
負債合計	101,429	108,740
純資産の部		
株主資本	36,256	38,983
資本金	12,888	12,888
資本剰余金	6,464	6,700
利益剰余金	17,648	21,317
自己株式	△745	△1,923
その他の包括利益累計額	4,161	5,190
その他有価証券評価差額金	39	36
繰延ヘッジ損益	250	△5
為替換算調整勘定	4,127	5,389
退職給付に係る調整累計額	△255	△229
非支配株主持分	192	153
純資産合計	40,610	44,327
負債純資産合計	142,040	153,068

連結損益計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期(累計) 2020年4月1日～ 2020年9月30日	当第2四半期(累計) 2021年4月1日～ 2021年9月30日
売上高	53,236	69,470
売上原価	46,499	57,310
売上総利益	6,736	12,160
販売費及び一般管理費	4,921	6,610
営業利益	1,814	5,549
営業外収益	445	357
営業外費用	1,700	559
経常利益	560	5,347
特別利益	2	12
特別損失	290	728
税金等調整前四半期純利益	272	4,631
法人税等	120	481
四半期純利益	152	4,149
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△42	△40
親会社株主に帰属する四半期純利益	194	4,190

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期(累計) 2020年4月1日～ 2020年9月30日	当第2四半期(累計) 2021年4月1日～ 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,308	2,344
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,702	△4,726
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,753	2,723
現金及び現金同等物に係る換算差額	△108	152
現金及び現金同等物の期首残高	13,646	12,121
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	229	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,126	12,615

財務のポイント

●連結貸借対照表

- ・当第2四半期連結会計期間末の総資産は153,068百万円となり、前連結会計年度末比11,027百万円増加。
- ・その主な要因は、流動資産では現金及び預金493百万円の増加、受取手形及び売掛金4,836百万円の増加、たな卸資産3,681百万円の増加、固定資産では有形固定資産1,276百万円の増加。
- ・当第2四半期連結会計期間末の負債は108,740百万円となり、前連結会計年度末比7,311百万円増加。

- ・その主な要因は、流動負債では支払手形及び買掛金1,655百万円の増加、短期借入金8,718百万円の増加、固定負債では長期借入金3,209百万円の減少。
- ・当第2四半期連結会計期間末の純資産は44,327百万円となり、前連結会計年度末比3,716百万円増加。
- ・その主な要因は、利益剰余金3,669百万円の増加、自己株式の取得等による1,178百万円の減少、為替換算調整勘定1,261百万円の増加。



株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2022年3月期上期の業績についてご報告申し上げます。

代表取締役社長 **名屋 佑一郎**

上期の業績について

当第2四半期連結累計期間における電子部品業界は、運転支援機能(ADAS)及びEVや5G向け需要が高まるとともに、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が全世界で進行し、全体としては回復基調で推移しました。一方、半導体不足やアセアン地域での新型コロナウイルス変異株の感染拡大による稼働制限があり、世界的なサプライチェーンの混乱が生じた結果、自動車やスマートフォン等の生産の調整などの影響が発生しました。今後についても新型コロナウイルス感染症の再拡大懸念や、中国における電力の供給制限など不透明感は引き続き継続しております。

このような状況の中、当社グループでは、中国およびベトナムにおいて本年8月に政府等要請による稼働制限があり、一時的に操業度の調整を行いました。その後はすべての工場においてフル稼働に近い水準で推移いたしました。受注面では今後の増産に備えた部品在庫積み上げの需要もあり、全体として好調に推移しております。販売面では、特に車載向け基板は好調に推移しました。スマートフォン向け基板、AI家電/IoT向け基板とEMS事業は、第1四半期において半導体不足の影響を受けましたが、その影響が緩和されつつあり、増加基調で推移いたしました。収益面においても、好調な受注を背景に工場の高稼働が継続したこと、全社的なコスト削減策等の施策により好調に推移しました。

通期の見通しについて

通期の見通しは、引き続き好調な業績を見込んでおります。受注面では車載向け基板が足元で電子部品や加工部品の不足により自動車減産の影響を受けておりますが、ADASやEV化の需要拡大が進行することや、現時点で多くの受注残を抱えていることなどから、下期もフル生産体制を継続する見通しとなっております。スマートフォン向け基板、AI家電/IoT向け基板、EMS事業についても受注は堅調に推移しております。収益面では中国における電力制限や資源価格の上昇による調達価格の上昇が見込まれますが、工場の稼働が高水準で推移する見通しであることから、通期の業績予想を修正し、売上高145,000百万円、営業利益12,000百万円、経常利益11,000百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益9,000百万円に上方修正することといたしました。

投資と収益改善の取り組み

収益改善の取り組みとして、2017年以降は自動化投資額を拡大して生産性の改善に努めてまいりました。また、2018年には、自動車分野における100年に1度の変革期とスマートフォン需要の大幅な拡大期となり、車載向け基板とスマートフォン向け基板の強化を目的としてベトナム工場の整備を行いました。残念ながらこの年から米中貿易摩擦が顕在化し中国の景気低迷や顧客の在庫調整、更に2019年に入り新型コロナウイルス感染症の拡大により世界的な経済の減速を迎え、当社の利益率も低下を余儀なくされました。前年度には徐々に景気の回復が進行し、当社の業績も大きく改善し、これまでの投資による生産能力の拡大の成果がでてまいりました。

今期は、モジュール・パッケージ基板向けの投資と、需要の拡大に合わせた投資を費用対効果を評価したうえで進めており、国内外で約120億円の投資を行います。

サステナビリティへの取り組み

当社は、気候変動や社会課題に対する取り組み強化のため、具体的な目標設定と戦略を立案・発信し、実行・評価するための仕組みを構築すべく、これまでのCSR推進体制を見直します。

サステナビリティ推進会議は社長直轄の機関として専務取締役を議長としサステナビリティに関連する方針の決定や目標の進捗管理・施策の審議等の機能を担います。

さらに関連部署と連携し、環境、社会、商品開発、人権、教育、広報・IR等の活動に施策を落とし込み、達成内容の評価等により継続的に展開し適宜取締役会にも報告してまいります。

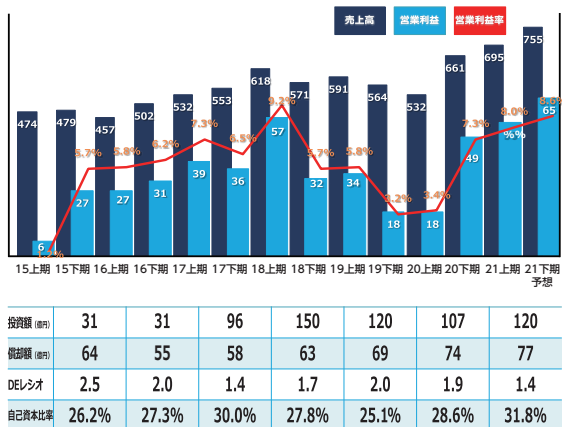
2022年3月期 上期 連結実績/通期予想 (単位: 億円)

	2021年 3月期 上期実績	2022年 3月期 上期実績	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率	2022年 3月期 下期予想	2022年 3月期 通期予想
売上高	532	695	163	30.5%	755	1,450
営業利益	18	55	37	205.8%	65	120
	3.4%	8.0%			8.6%	8.3%
経常利益	6	53	47	854.3%	57	110
	1.1%	7.7%			7.5%	7.6%
親会社株主に帰属する 当期純利益	2	42	40	2052.5%	49	90
	0.4%	6.0%			6.5%	6.2%
期中平均為替レート (円/US\$)	106.30	110.12			112	111.06
1株当たり配当金	0円	20円			20円	40円

2022年3月期 上期商品別実績・通期予想 (単位: 億円)

	2021年3月期 上期実績		2022年3月期 上期実績		前年 同期比 増減額	前年 同期比 増減率	2022年3月期 下期予想		2022年3月期 通期予想	
	売上	営業利益	売上	営業利益			売上	営業利益	売上	営業利益
車載	222	9	348	29	126	20	363	31	711	60
	4.1%		8.3%	56.8%	222%		8.5%		8.4%	
スマートフォン タブレット	127	10	146	16	19	6	164	19	310	35
	7.9%		11.0%	15.0%	60.0%		11.6%		11.3%	
AI家電・IoT・ アミューズメント	50	1	51	6	1	5	56	7	107	13
	2.0%		11.8%	2.0%	500.0%		12.5%		12.1%	
その他基板	78	0	97	5	19	5	94	5	191	10
	0.0%		5.2%	24.4%	-		5.3%		5.2%	
EMS	55	-2	53	-1	-2	1	78	3	131	2
	-3.6%		-1.9%	-3.6%	-		3.8%		1.5%	
合計	532	18	695	55	163	37	755	65	1,450	120
	3.4%		8.0%	30.6%	205.6%		8.6%		8.3%	

売上高・営業利益他推移 (単位: 億円)



投資額 (億円)	31	31	96	150	120	107	120
設備額 (億円)	64	55	58	63	69	74	77
O/Eノイ	2.5	2.0	1.4	1.7	2.0	1.9	1.4
自己資本比率	26.2%	27.3%	30.0%	27.8%	25.1%	28.6%	31.8%

MEICOグループは企業理念に基づき、健全で透明性の高い経営と社会・環境に調和した事業活動を通じて、ステークホルダーの皆さまの信頼をより確かなものにするとともに、社会の持続的発展への貢献と中長期的な企業価値の向上を図るため積極的にサステナビリティ活動を推進します。



今後の戦略

当社は、車載向け基板および、スマートフォン向け基板の生産を、当社の業績を牽引する主要な事業の柱としております。
ここでは、車載向け基板と第3の柱となるモジュール・パッケージ基板の成長戦略についてお伝えいたします

車載向け基板成長戦略

自動車分野では、通信機能として自動車ソフトウェアや地図の更新、安全運転機能としてADAS搭載車の増加、環境対策として電動化が進行しており、それぞれの機能においてプリント基板が必要になります。また、2022年販売の新車からADASの装着が義務化され、運転支援のためのセンシング用基板や自動運転用途に用いる基板の需要が拡大し、これを統合する中央集権型ECUへの進化が徐々に進行し、今後大きなプリント基板需要が生まれることが想定されております。

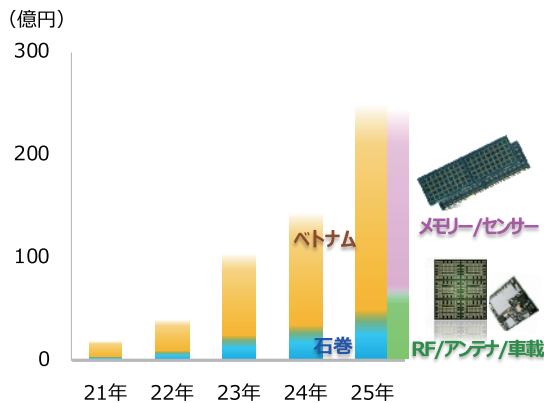
当社はこうした需要をキャッチアップするため、山形県天童市に先端車載基板工場を建設することといたしました。この工場は先端車載基板分野のモデル工場として顧客のニーズをキャッチアップする重要な工場となります。工場の建設にあたっては、投資を2期に分けて順次拡大する計画です。1期目に100億円を投資し、生産能力100億円の工場を建設します。2期目に更に100億円を投資し、生産能力100億円のラインを追加、完成時には年間販売金額200億円の工場とします。この他に、基板技術の開発や、自動化設備の開発製造、EMS事業の国内工場として整備を進めてまいります。

モジュール・パッケージ基板成長戦略

モジュール・パッケージ基板分野は、ICの高速化・高集積化・低消費電力化や、搭載される電子機器の小型化により基板仕様が高精細化してきており、需要が高まりつつあります。当社でも顧客からの引き合いが増えつつあり、これまで石巻工場やタンロン工場で生産を行ってきました。昨年度から、技術仕様の高度化や生産性の改善を目的としてベトナム第3工場内にモジュール・パッケージ基板専用ラインの整備を進めており、来期は本格的な生産を開始いたします。

モジュール・パッケージ基板分野は今後も成長分野として魅力的なマーケットであり、同時に高集積化がさらに進行することから、追加投資を行い、当社の次世代の柱として育成してまいります。

モジュール・パッケージ基板事業売上計画



ベトナム第3工場は過年度分を含め累計で160億円の投資を行います。石巻第2工場では50億円の投資を行います。これによる成長性は上記のグラフに示した通り、2025年に200億円を上回る売上を目指してまいります。

配当金について

当期中間配当は、1株当たり20円とさせていただきます。期末の配当につきましては、1株当たり20円を予定しております。
株主の皆様をはじめすべてのステークホルダーのご支援、ご期待に応えるべく、施策に対して全力で取り組み、企業価値の向上と持続的な成長に努めてまいります。

今後とも一層のご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

車載向け基板 技術ロードマップ

マクロ環境	2025年	2030年	2035年
自動運転 EV/FCV	ADAS義務化(22年～) 中国レベル3 50%	米国 50%(PHV含む) 英国 全車	中国、日本 全車(HV含む) IEA, EU, 加州 全車
車載向け基板	2021年	2023年	2025年
コネクテッド (通信モジュール)	4G通信 TCU市場成長 (高密度化: 10～12層工ニレイヤー基板)		5G通信 本格普及 (基板サイズ大型化)
ADAS (センシング)	カメラ+レーダー+LIDAR 台数増加 (高周波材料ハイブリッド構造基板)		次世代ミリ波検討 (100GHz帯 高周波材料)
ADAS (E/Eアーキテクチャ)	分散型ECU⇒ドメイン統合型ECUへ移行 (高密度化: スタックピッチ基板、インピーダンス制御基板)		中央集権型ECUへ移行 (コンピュータ基板)
EV電動化 (パワー素子放熱)	電動ブレーキ、電動パワーステアリング、LEDヘッドランプ 台数増加 (放熱基板、FR-4フレックス基板)		800V 高電圧化 (高放熱・高耐圧基板)



モジュール・パッケージ基板 技術ロードマップ

半導体パッケージ動向				
リードフレーム	PBGA	FC-CSP	FC-BGA	微細化/多ピン化
ディスクリート 半導体	メモリ フロントエンドモジュール	スマートフォン エッジ	車載マイコン PC, ゲーム	ネットワーク サーバー
基板他社動向	PBGA/FC-CSPメカはFC-BGA参入		FC-BGAメカはキャパ拡大	
基板	2021年	2023年	2025年	
パッケージタイプ	PBGA (メモリ/フロントエンドモジュール)	PBGA / FC-CSP (アプリケーション拡大)		
回路形成	MSAP (L/S=25/25um) SAP開発	MSAP (L/S=20/20um) SAP生産		
パッケージ基板断面 厚さ0.1mm以下				





取締役常務執行役員
坂手 敦

2022年3月期上半期は様々な外的要因により大きな影響を受けましたが、全従業員の努力により大きな成果をあげる事が出来ました。

現在私は製造本部という立場でメイコーの5年後、10年後を考えた中長期戦略の策定を検討しております。今までメイコーは海外工場を中心とした大きなキャパシティを武器にお客様を増やして参りましたが、コロナ後のエレクトロニクス業界も大幅な変化を見せており、それらに迅速に対応するため、地産地消を考慮した国内事業の強化や、リモートワークが増え半導体需要の大幅な拡大に対応した最先端分野であるモジュール・パッケージ基板事業の強化を進めています。

おそらくこの基板業界に於いて一般貫通板から放熱基板、ビルドアップ、FPC、モジュール・パッケージ基板まで幅広いラインアップを日本・中国・アジアから供給できる会社はないと思います。

我々が目指すべきゴールはこのようなあらゆるエレクトロニクス関連のお客様を満足させられるサービスを提供する事であり、それらが、今後のメイコーの更なる飛躍につながると確信しております。

今後もこのような方針のもと、全社一丸となってこれらのミッションに立ち向かってまいります。引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

コーポレートデータ (2021年9月30日現在)

会社概要

商号	株式会社メイコー
設立	1975年11月25日
資本金	12,888百万円
従業員数	13,103名(連結) (国内877名・海外12,226名)
主な事業内容	電子回路基板等の設計、製造および販売ならびにこれらの付随業務に関する電子関連事業

役員

代表取締役社長執行役員	名屋 佑一郎
取締役専務執行役員	篠崎 政邦
取締役専務執行役員	篠崎 純也
取締役常務執行役員	松田 孝広
取締役常務執行役員	坂手 敦
取締役常務執行役員	桔 梗芳
取締役執行役員	申 允浩
取締役執行役員	土屋 奈生
取締役執行役員	西原 山田
取締役執行役員	小原 林俊
取締役執行役員	露木 豊彦
取締役執行役員	佐藤 孝幸
取締役執行役員	宮内 弘幸

関連会社

株式会社山形メイコー	電子関連事業
株式会社メイコーテック	電子関連事業
株式会社メイコーテクノ	電子関連事業
名幸電子(広州南沙)有限公司	電子関連事業
名幸電子(武漢)有限公司	電子関連事業
名幸電子香港有限公司	電子関連事業
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics America, Inc.	電子関連事業
Meiko Electronics Europe GmbH	電子関連事業
Meiko Towada Vietnam Co., Ltd.	電子関連事業

株主情報

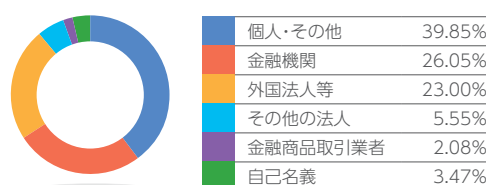
発行可能株式総数	70,000,000株
発行済株式の総数	25,871,947株 (自己株式 931,373株を除く)
株主数	5,024名

大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
名屋 佑一郎	4,704	18.18
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2,432	9.40
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	1,717	6.63
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC /FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS	1,250	4.83
CLEARSTREAM BANKING S.A.	1,013	3.91
名幸興産株式会社	608	2.35
BANQUE PICTET AND CIE SA	600	2.32
有限会社ユーホー	521	2.01
名屋 精一	435	1.68
株式会社三井住友銀行	377	1.46

※当社は、自己株式931,373株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。
また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

所有者別株式分布状況(普通株式)



株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月開催
基準日	期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(郵便物送付先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	☎ 0120-782-031
上場証券取引所	東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード)
公告の方法	電子公告により当社ウェブサイトに掲載 https://www.meiko-elec.com/ir/pa.shtml ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載

株式に関するお問合せ

- 住所変更、配当金受取り方法の変更等のお手続きは、お取引の証券会社にお問合せください。
- 証券会社の口座をご利用でない株主様、未払配当金のお手続きは、上記三井住友信託銀行証券代行部にお問合せください。